

JEITA

電子情報技術産業協会規格

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA ED-7701A

半 導 体 ソ ケ ッ ト 用 語 (BGA, LGA, FBGA 及び FLGA)

**Glossary of semiconductor socket
for BGA, LGA, FBGA and FLGA**

1999 年 8 月制定

2012 年 3 月改正

作 成

半導体技術委員会／半導体実装・製品技術専門委員会

Semiconductor Technology Committee/Semiconductor Product Technology Committee of Japan

半導体パッケージ技術小委員会

Technical Committee on Semiconductor Packaging

発 行

一般社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

まえがき

この規格は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）電子デバイス部 半導体パッケージ技術小委員会 半導体ソケットサブコミティが作成したものである。

この規格は、国際規格に整合するために制定された次の規格に基づいて、**JEITA TSC-16**（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成した規格である。

この規格は、著作権法によって保護されている著作物であるため、許可なくこの規格の一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。

この規格は、その一部が工業所有権（特許権，実用新案権，意匠権など）に抵触する可能性に関係なく，作成されている。一般社団法人 電子情報技術産業協会は，このような工業所有権に係る確認について，責任はもたない。

電子情報技術産業協会規格

半導体ソケット用語 (BGA, LGA, FBGA 及び FLGA)

Glossary of semiconductor socket for BGA, LGA, FBGA and FLGA

1 適用範囲

この規格は、BGA, LGA, FBGA 及び FLGA 用のテスト・アンド・バーンイン・ソケットに関する用語（以下、用語という。）の意味について規定する。

2 引用規格及び文書

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、Amendment 又は追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は、その最新版（Amendment・追補を含む）を適用する。

a) JEITA 文書

JEITA TSC-16:2007 電子情報技術産業協会規格類の作成基準

b) 対応国際規格

IEC 60191-6-16 Ed. 1.0:2007 (en) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-16: Glossary of semiconductor tests and burn-in sockets for BGA, LGA, FBGA and FLGA

c) 関連規格

EIAJ RC-5200 (1993) コネクタ用語

3 用語及び定義

用語及び定義は、次のとおりとする。なお、対応英語を参考として示す。

3.1 分類

用語の分類は、次による。

- a) 一般
- b) クラムシェル・タイプ
- c) オープントップ・タイプ
- d) プリント配線板関係

3.2 備考

- a) 用語が長い場合は、2行にて示す。
- b) 照合文字の記号は図中の寸法記号を示す。
- c) 図・部位及び記号欄が「—」のときは対応なきを示す。



Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA ED-7701A

**Glossary of semiconductor socket
for BGA, LGA, FBGA and FLGA**

Established in August, 1999

Revised in March, 2012

Prepared by

Semiconductor Technology Committee
Semiconductor Product Technology Committee of Japan
Technical Committee on Semiconductor Packaging

Published by

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

Ote Center Bldg., 1-3, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, Japan

Printed in Japan

In case of a disagreement between the translation and the original version of the standard or technical report in Japanese, the original version will prevail.

© JEITA :2012 - Copyright - all reserved

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means without permission in writing from the publisher.

FOREWORD

This Standard has been created by Subcommittee on Semiconductor Socket, Technical committee on Semiconductor Packaging, Electronic Device Dept. of Japan Electronics and Information Technology Industries Association.

This Standard was prepared in compliance with the format **TSC-16**, Rules for the layout and drafting of **JEITA** Standards.

This standard is a publication protected by copyright law and no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means without permission of the **JEITA**.

Attention is called to the possibility that some of the elements of this standard may be the subject of patent rights including patent, utility model and design registration, **JEITA** shall not be held responsibility for identifying any or all such patent right.

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

Glossary of semiconductor socket for BGA, LGA, FBGA and FLGA

1 Scope of Application

This standard provides for the definition of terms (herein after referred as terms) on test and burn-in sockets for BGA, LGA, FBGA and FLGA.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for application of this document. For dated references, only the cited applies. For undated references, only the latest edition of the referenced document applies.

a) JEITA Standard

JEITA TSC-16:2007 Rules for the layout and drafting of **JEITA** Standard

b) Corresponding International Standard

IEC 60191-6-16 Ed. 1.0:2007 (en) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-16: Glossary of semiconductor tests and burn-in sockets for BGA, LGA, FBGA and FLGA

c) Related Standard

EIAJ RC-5200 (1993) Terms and Definitions for Connectors

3 Classification

Terms and definition are as follows. Corresponding English is provided.

3.1 Classification

The terms are classified as follows.

- a) General
- b) Clamshell type
- c) Open top type
- d) Printed circuit board

3.2 Terms and Definitions

Terms and definition are as follows.

- a) Long terms are indicated in two lines.
- b) Symbol indicates dimensional symbol in drawing.
- c) (-) in columns of Drawing, Part and Symbol indicates no correspondence to Symbols or Drawing, Part.